

03 本庁舎等整備工事News

令和7年3月号 Vol.16 作成/庁舎整備担当部庁舎建設担当課 〒154-8504 世田谷区世田谷4-22-33
☎03-5432-2986 FAX03-5432-3006 協力/大成建設株式会社東京支店

現在、2期棟建設地で、掘削工事を進めています



北側(国土館大学側)より、工事敷地全体の状況を撮影

世田谷区役所通りの歩道通行止めを令和7年7月頃まで延期させていただきます。

世田谷区役所通りの旧第1庁舎側歩道は、本庁舎等整備工事に伴う通行制限を実施中であり、解除予定を令和7年3月頃とご案内しておりました。

このたび、区が同道路で並行して実施している電線共同溝整備事業を、より安全・確実に実施するため、当該歩道の通行制限を令和7年7月頃まで延長します。

ご近隣、地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。



通行止めとなる歩道
(国土館大学側交差点より)

東2期棟建設地

掘削工事の状況



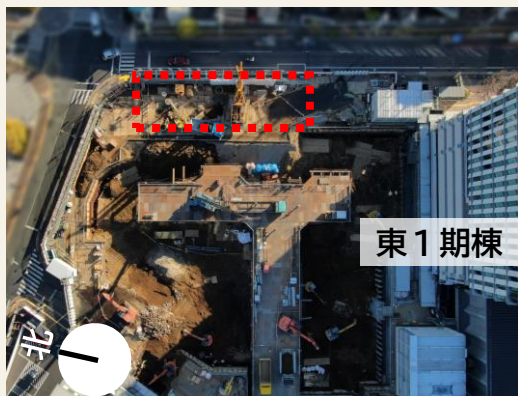
東側敷地内に、掘削工事を円滑に行うための作業構台(仮設の工事用通路)を組み立てました。令和7年1月24日時点で、約8mまで掘削し、令和7年3月までに約13メートルの深さまで掘り進めます。

BG工法にて解体を行いました

BG工法とは、油圧式多機能大口径削孔機(BG機)を使用した解体工法で、先端にダイヤモンドカッターが付いた鋼管を回転させながら地中に押し込むことで、地中の工作物を円筒状にくり抜き除去する工法です。構造物や境界際に近接した狭隘部での解体で威力を発揮します。旧第一庁舎では、一部の地下躯体が、東側道路境界に近接していたため、この工法を用いて解体しました。

地中工作物の解体後、区役所通り側では工事ゲートを2箇所とし、今後の工事をより効率的に進める計画とします。

※BGとはドイツ語で”Bohr Geräte”
(孔掘り機械)の略です。



BG工法での解体範囲



BG工法に用いた鋼管



BG工法により除去した地中工作物

西2期棟建設地

掘削工事の状況

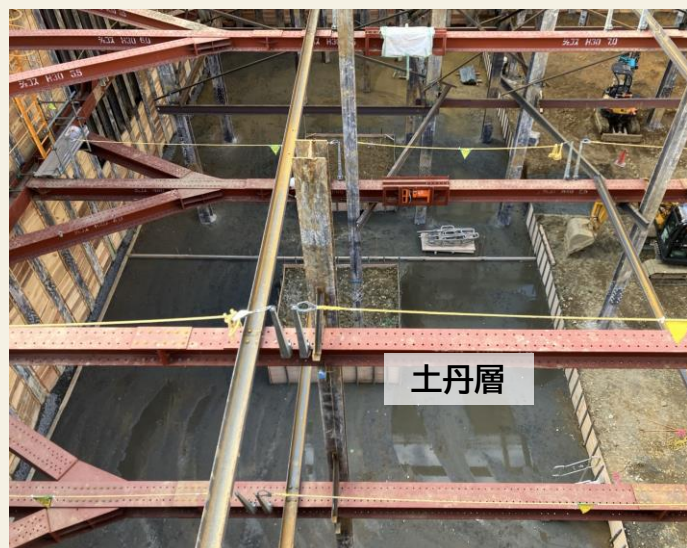
西側敷地は、約13メートルの深さまでの掘削工事が完了しました。今後は、躯体工事に着手していきます。西棟では、山留壁に切梁(突っ張り棒の役割を担う水平材)を設置し、「プレロード」と呼ばれる、山留壁を外側に押す力(軸力)をかける作業を実施しました。軸力は切梁を解体するまで、測定器で管理していきます。



西棟敷地掘削工事の進捗状況

掘削工事を完了した地下13mの地盤(根切底)は、粘土層が長い年月をかけて圧密され、非常に硬い岩のようになった土丹(どたん)層と呼ばれる地層です。

改めて、この地盤について、重機を重石として平板載荷試験を行い、今後築造する建物の支持地盤としての十分な地耐力があることを確認しました。



建物の支持地盤となる土丹(どたん)層

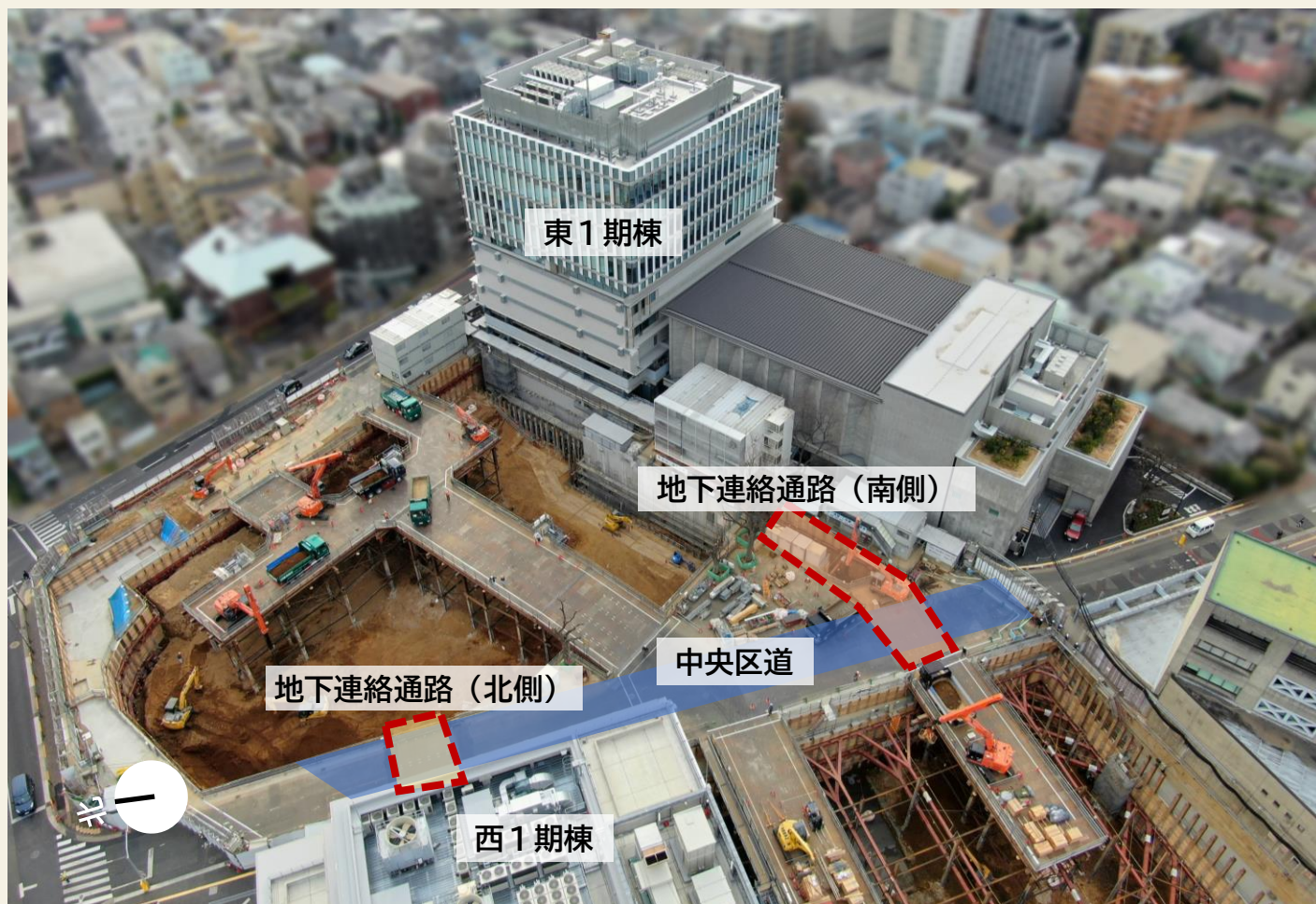


平板載荷試験の状況

中央区道

地下連絡通路の掘削工事の状況

新庁舎には、東西棟を、それぞれ地下1・2階でつなく連絡通路を新設します。現在、中央区道では、この連絡通路の工事を進めています。現在は掘削工事を終え、令和7年3月より、順次、躯体工事に着手します。



地下連絡通路（北側）の状況



地下連絡通路（南側）の状況